

2018-2024年中国芯片未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2018-2024年中国芯片未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/356648.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告目录：

第一章 芯片行业的总体概述

1.1 基本概念

1.2 制作过程

1.2.1 原料晶圆

1.2.2 晶圆涂膜

1.2.3 光刻显影

1.2.4 掺杂杂质

1.2.5 晶圆测试

1.2.6 芯片封装

1.2.7 测试包装

第二章 2014-2017年全球芯片产业发展分析

2.1 2014-2017年世界芯片市场综述

2.1.1 市场特点分析

2.1.2 全球市场规模

2.1.3 市场竞争格局

2.2 2014-2017年美国芯片产业分析

2.2.1 市场发展格局

2.2.2 行业并购情况

2.2.3 类脑芯片发展

2.2.4 技术研发动态

2.3 2014-2017年日本芯片产业分析

2.3.1 产业订单规模

2.3.2 技术研发进展

2.3.3 芯片工厂布局

2.3.4 日本产业模式

2.3.5 产业投资动态

2.4 2014-2017年韩国芯片产业分析

2.4.1 产业发展阶段

2.4.2 市场格局分析

2.4.3 市场发展规模

2.4.4 市场发展策略

2.5 2014-2017年印度芯片产业分析

2.5.1 芯片设计发展形势

2.5.2 产业发展困境分析

2.5.3 产业发展对策分析

2.5.4 未来发展机遇分析

2.6 其他国家芯片产业发展分析

2.6.1 英国

2.6.2 德国

第三章 2014-2017年中国芯片产业发展环境分析

3.1 政策环境分析

3.1.1 智能制造政策

3.1.2 集成电路政策

3.1.3 智能传感器政策

3.1.4 “互联网+”政策

3.2 经济环境分析

3.2.1 国民经济运行状况

3.2.2 工业经济增长情况

3.2.3 固定资产投资情况

3.2.4 经济转型升级形势

3.2.5 宏观经济发展趋势

3.3 社会环境分析

3.3.1 互联网加速发展

3.3.2 智能芯片不断发展

3.3.3 科技人才队伍壮大

3.3.4 万物互联带来需求

3.4 技术环境分析

3.4.1 技术研发进展

3.4.2 无线芯片技术

3.4.3 技术发展方向

第四章 2014-2017年年中国芯片产业发展分析

4.1 2014-2017年中国芯片产业发展状况

4.1.1 产业发展背景

4.1.2 产业发展意义

4.1.3 产业发展成就

4.1.4 产业发展规模

4.1.5 产业加速发展

4.1.6 产业发展契机

4.2 2014-2017年中国芯片市场格局分析

4.2.1 厂商经营现状

4.2.2 区域布局状况

4.2.3 市场发展形势

4.3 2014-2017年中国量子芯片发展进程

4.3.1 产品发展历程

4.3.2 市场发展形势

4.3.3 产品研发动态

4.3.4 未来发展前景

4.4 2014-2017年芯片产业区域发展动态

4.4.1 湖南

4.4.2 上海

4.4.3 北京

4.4.4 深圳

4.4.5 晋江

4.4.6 西安

4.5 中国芯片产业发展困境分析

4.5.1 市场垄断困境

4.5.2 过度依赖进口

4.5.3 技术短板问题

4.6 中国芯片产业应对策略分析

4.6.1 突破垄断策略

4.6.2 产业发展对策

4.6.3 加强技术研发

第五章 2014-2017年中国芯片产业上游市场发展分析

5.1 2014-2017年中国半导体产业发展分析

5.1.1 产业链结构

5.1.2 行业发展意义

5.1.3 产业发展基础

5.1.4 产业发展态势

5.1.5 产业规模现状

5.1.6 产业投资基金

5.2 2014-2017年中国芯片设计行业发展分析

5.2.1 产业发展历程

5.2.2 市场发展现状

5.2.3 市场销售规模

5.2.4 产业区域分布

5.3 2014-2017年中国晶圆代工产业发展分析

5.3.1 晶圆加工技术

5.3.2 晶圆制造工艺

5.3.3 晶圆工厂分布

5.3.4 企业竞争现状

5.3.5 行业发展展望

第六章 2014-2017年芯片设计行业重点企业经营分析

6.1 高通 (Qualcomm)

6.1.1 企业发展简况分析

6.1.2 企业经营情况分析

6.1.3 企业经营优劣势分析

6.2 博通有限公司

6.2.1 企业发展简况分析

6.2.2 企业经营情况分析

6.2.3 企业经营优劣势分析

6.3 英伟达 (NVIDIA Corporation)

6.3.1 企业发展简况分析

6.3.2 企业经营情况分析

6.3.3 企业经营优劣势分析

6.4 美国超微公司 (AMD)

6.4.1 企业发展简况分析

6.4.2 企业经营情况分析

6.4.3 企业经营优劣势分析

6.5 Marvell

6.5.1 企业发展简况分析

6.5.2 企业经营情况分析

6.5.3 企业经营优劣势分析

6.6 赛灵思 (Xilinx)

6.6.1 企业发展简况分析

6.6.2 企业经营情况分析

6.6.3 企业经营优劣势分析

6.7 Cirrus logic

6.7.1 企业发展简况分析

6.7.2 企业经营情况分析

6.7.3 企业经营优劣势分析

6.8 联发科

6.8.1 企业发展简况分析

6.8.2 企业经营情况分析

6.8.3 企业经营优劣势分析

6.9 展讯

6.9.1 企业发展简况分析

6.9.2 企业经营情况分析

6.9.3 企业经营优劣势分析

6.10 其他企业

6.10.1 海思

6.10.2 瑞星

6.10.3 Dialog

第七章 2014-2017年晶圆代工行业重点企业经营分析

7.1 格罗方德

7.1.1 企业发展概况

7.1.2 企业发展趋向

7.1.3 企业发展战略

7.1.4 未来发展规划

7.2 三星 (Samsung)

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 2015年经营状况

7.2.3 2016年经营状况

7.2.4 2017年经营状况

7.3 Tower jazz

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 2015年经营状况

7.3.3 2016年经营状况

7.3.4 2017年经营状况

7.4 富士通

7.4.1 企业发展概况

7.4.2 2015财年经营状况

7.4.3 2016财年经营状况

7.4.4 2017财年经营状况

7.5 台积电

7.5.1 企业发展概况

7.5.2 2015年经营状况

7.5.3 2016年经营状况

7.5.4 2017年经营状况

7.6 联电

7.6.1 企业发展概况

7.6.2 2015年经营状况

7.6.3 2016年经营状况

7.6.4 2017年经营状况

7.7 力晶

7.7.1 企业发展概况

7.7.2 2015年经营状况

7.7.3 2016年经营状况

7.7.4 2017年经营状况

7.8 中芯

7.8.1 企业发展概况

7.8.2 2015年经营状况

7.8.3 2016年经营状况

7.8.4 2017年经营状况

7.9 华虹

7.9.1 企业发展概况

7.9.2 2015年经营状况

7.9.3 2016年经营状况

7.9.4 2017年经营状况

第八章 2014-2017年中国芯片产业中游市场发展分析

8.1 2014-2017年中国芯片封装行业发展分析

8.1.1 封装技术介绍

8.1.2 市场发展现状

8.1.3 国内竞争格局

8.1.4 技术发展趋势

8.2 2014-2017年中国芯片测试行业发展分析

8.2.1 芯片测试原理

8.2.2 测试准备规划

8.2.3 主要测试分类

8.2.4 发展面临问题

8.3 中国芯片封测行业发展方向分析

8.3.1 行业发展机遇

8.3.2 集中度持续提升

8.3.3 产业竞争加剧

8.3.4 产业短板补齐升级

第九章 2014-2017年芯片封装测试行业重点企业经营分析

9.1 Amkor

9.1.1 企业发展概况

9.1.2 2015年经营状况

9.1.3 2016年经营状况

9.1.4 2017年经营状况

9.2 日月光

9.2.1 企业发展概况

9.2.2 2015年经营状况

9.2.3 2016年经营状况

9.2.4 2017年经营状况

9.3 矽品

9.3.1 企业发展概况

9.3.2 2015年经营状况

9.3.3 2016年经营状况

9.3.4 2017年经营状况

9.4 南茂

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 2015年经营状况

9.4.3 2016年经营状况

9.4.4 2017年经营状况

9.5 长电科技

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 经营效益分析

9.5.3 业务经营分析

9.5.4 财务状况分析

9.5.5 核心竞争力分析

9.5.6 未来前景展望

9.6 天水华天

9.6.1 企业发展概况

9.6.2 经营效益分析

9.6.3 业务经营分析

9.6.4 财务状况分析

9.6.5 核心竞争力分析

9.6.6 公司发展战略

9.6.7 未来前景展望

9.7 通富微电

9.7.1 企业发展概况

9.7.2 经营效益分析

9.7.3 业务经营分析

9.7.4 财务状况分析

9.7.5 核心竞争力分析

9.7.6 公司发展战略

9.8 士兰微

9.8.1 企业发展概况

9.8.2 经营效益分析

9.8.3 业务经营分析

9.8.4 财务状况分析

9.8.5 核心竞争力分析

9.8.6 公司发展战略

9.8.7 未来前景展望

9.9 其他企业

9.9.1 颀邦

9.9.2 UTAC

9.9.3 J-Device

第十章 2014-2017年中国芯片产业下游应用市场发展分析

10.1 LED

10.1.1 芯片产值规模

10.1.2 企业发展动态

10.1.3 封装技术难点

10.1.4 行业规模预测

10.1.5 LED产业趋势

10.2 物联网

10.2.1 产业链的地位

10.2.2 市场发展状况

10.2.3 细分市场规模

10.2.4 物联网wifi芯片

10.2.5 国产化的困境

10.2.6 产业发展困境

10.3 无人机

10.3.1 无人机产业链

10.3.2 中国市场规模

10.3.3 市场竞争格局

10.3.4 主流主控芯片

10.3.5 芯片应用领域

10.3.6 市场前景趋势

10.4 北斗系统

10.4.1 北斗芯片概述

10.4.2 产业发展态势

10.4.3 芯片产销状况

10.4.4 芯片研发进展

10.4.5 资本助力发展

10.4.6 产业发展趋势

10.5 智能穿戴

10.5.1 行业发展规模

10.5.2 市场竞争格局

10.5.3 核心应用芯片

10.5.4 芯片厂商对比

10.5.5 行业发展方向

10.5.6 商业模式探索

10.6 智能手机

10.6.1 市场发展状况

10.6.2 手机芯片销量

10.6.3 无线充电芯片

10.6.4 市场竞争格局

10.6.5 产品性能情况

10.7 汽车电子

10.7.1 行业发展状况

10.7.2 芯片制造标准

10.7.3 车用芯片市场

10.7.4 车用芯片格局

10.7.5 汽车电子渗透率

10.7.6 未来发展前景

10.8 生物医药

10.8.1 基因芯片介绍

10.8.2 主要技术流程

10.8.3 技术应用情况

10.8.4 重点企业分析

10.8.5 生物研究的应用

10.8.6 发展问题及前景

第十一章 2014-2017年中国集成电路产业发展分析

11.1 2014-2017年集成电路市场规模分析

11.1.1 全球市场规模

11.1.2 全球收入规模

11.1.3 中国销售规模

11.1.4 中国进口规模

11.1.5 中国出口规模

11.2 2014-2017年中国集成电路市场竞争格局

11.2.1 进入壁垒提高

11.2.2 上游垄断加剧

11.2.3 内部竞争激烈

11.3 提升集成电路产业核心竞争力方法

11.3.1 提高扶持资金集中运用率

11.3.2 制定融资投资制度

11.3.3 提高政府采购力度

11.3.4 建立技术中介服务制度

11.3.5 人才引进与人才培养

11.4 中国集成电路产业发展的问题及对策

11.4.1 产业发展问题

11.4.2 产业发展策略

11.4.3 “十三五”发展建议

11.5 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析

11.5.1 全球市场趋势

11.5.2 国内行业趋势

11.5.3 行业机遇分析

11.5.4 行业发展预测

第十二章 2014-2017年中国芯片行业投资分析

12.1 投资机遇及方向分析

12.1.1 投资价值较高

12.1.2 战略资金支持

12.1.3 投资需求上升

12.1.4 投资大周期开启

12.1.5 大基金投资方向

12.2 行业投资分析

12.2.1 投资研发加快

12.2.2 融资动态分析

12.2.3 阶段投资逻辑

12.2.4 国有资本为重

12.3 行业并购分析

12.3.1 全球产业并购规模

12.3.2 全球产业并购动态

12.3.3 国内并购动态分析

12.4 投资风险分析

12.4.1 贸易政策风险

12.4.2 贸易合作风险

12.4.3 宏观经济风险

12.4.4 技术研发风险

12.4.5 环保相关风险

12.4.6 产业结构性风险

12.5 融资策略分析

12.5.1 项目包装融资

12.5.2 高新技术融资

12.5.3 BOT项目融资

12.5.4 IFC国际融资

12.5.5 专项资金融资

第十三章 中国芯片产业未来前景展望（AK LT）

13.1 中国芯片市场发展机遇分析

13.1.1 中国产业发展机遇分析

13.1.2 国内市场变动带来机遇

13.1.3 芯片产业未来发展趋势

13.2 中国芯片产业细分领域前景展望

13.2.1 芯片材料

13.2.2 芯片设计

13.2.3 芯片制造

13.2.4 芯片封测

图表目录：

图表1 2015-2017年全球芯片厂商销售额TOP10

图表2 日本综合电机企业的半导体业务重组

图表3 东芝公司半导体事业改革框架

图表4 智能制造系统架构

图表5 智能制造系统层级

图表6 MES制造执行与反馈流程

图表7 云平台体系架构

图表8 《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标

图表9 《中国集成电路产业“十三五”发展规划建议》发展目标

图表10 2013-2017年国内生产总值及其增长速度

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/356648.html>